

晶圆背面研磨保护

背面研磨保护胶带 214D

特征

背面研磨胶带用于晶圆背面研磨时，保护回路面避免受到外部异物造成刮伤、裂痕或污染所使用。

- 对于回路面等凹凸晶圆具有优越黏着性
- 能轻易撕除

用途 半导体 晶圆研磨清洗工程

构造

	粘着層	0.08mm
	基材 (PET)	0.025mm
	粘着層	0.03mm

特性

规格 基材 聚酯树脂

物性

品名	厚み (mm)	粘着力	
		強粘着面 (N/25mm)	弱粘着面 (N/25mm)
214D	0.135	25	15

*PET#25背面 被贴物: 不锈钢
贴合后放置24小时
拉的角度 300mm/min 180度撕除

使用时的注意事项

- 所有技术数据皆是在共同技研(股)的实验室中进行测试和实际测量。
但是，产品特性依环境或被贴物不同而有很大差异。
因此，特性数据是参考值而非保证值。
使用前，请确认本产品用途和适合环境。
- 上記测量是在室温(23° C)下进行的。当温度较低(低于5°C)时，黏着力可能会大幅下降。

保管注意

- 请务必装箱保管。
- 保管场所请选择阴凉处，避免阳光直射。
尤其不要暴露在高温高湿的环境中(严格禁止在温度30° C以上 湿度50%以上)。

2019年12月 発行

共同技研化学有限公司
崎玉县所泽市南永井940牌号 940
3590011

Tel : +81 4 2944 5151

Mail : info-k@kgk-tape.co.jp

URL : <https://www.kgk-tape.co.jp/>